宝迪蓄电池6-GFM-24 12V24AH机房储能

产品名称	宝迪蓄电池6-GFM-24 12V24AH机房储能
公司名称	北京恒泰正宇科技有限公司
价格	.00/只
规格参数	品牌:宝迪 型号:6-GFM-24 规格:12V24AH
公司地址	北京市通州区中关村科技园区通州园区国际种业科技园区聚和七街2号-153
联系电话	13520887406

产品详情

宝迪蓄电池6-GFM-24 12V24AH机房储能

免费维修

H2O再生能力强，密封反应效率高，吸附式玻璃纤维棉技术使气体满足效率高达99%，电解质具有免费维护功能 因此，电池无需补水或填充整个过程中使用酸来维护。

安全可靠

正常使用下无电解液漏出,电池外壳无膨胀及破裂现象，3、正、负极必须接正确电池内部装有特制安全阀和防暴装置，能有效隔离外部火花高频逆变电源以其体积小，重量轻，效率高，操作简单，无污染等优点，深受广大用户喜爱；而工频逆变电源在相对恶劣的环境下都能使用，具有稳定性强，可靠性高，保护功能全等优点，同时还有很强的非线性负载驱动能力，可制作大功率电源，深受客户的好评。
，不会引起电池内部发生爆炸，使电池在整个使用过程中更加安全可靠。 艾默生网络能源在工业市场的发展之路，与近年来中国工业化与信息化的融合之路比肩而行。新型工业化，需要信息通信技术、自动化技术的支持，从而更需要保障这些技术的网络动力的支撑。作为网络动力整体解决方案的主流提供商，艾默生网络能源始终将工业市场作为发展重点之一，为该市场提供了十足的动力支持。

UPS使用的注意要点 UPS虽然智能化程度较高,储能设备也可选用免维护蓄电池,这给我们使用带来了许多便利,但在其使用过程中还应注意许多方面,才能保证使用。 加上潮湿会引起主机工作紊乱。蓄电池组对温度的要求较高，标准使用温度为25℃，室内温度应在+(15～30)℃。温度过低，会使蓄电池容量下降,温度每下降1℃，其容量下降1%。如果长期在高温下使用，温度每升高10℃，电池的寿命约降低一半。
(2)参数设置 主机中设置的参数在使用中不能随意更改,特别是电池组的参数,会直接影响其使用寿命。但随环境温度的改变,对浮充电压要做相应调整,通常以25℃为标准,环境温度每变化1℃时,浮充电压也相应变

化18mV(相对于12V蓄电池)。

长寿命设计

通过计算机精密设计的耐腐蚀钙铅锡等多元合金板栅，ABS耐腐蚀材料外壳， 中发高频机，采用国际高端IGBT、数字IC、水冷电容、低耗高频变压器等。工作电压范围达350V--420V,可连续24小时不间断工作。质优价廉，节电70%，保修2年，保用15年。高强度紧装配工艺，提高电池装配紧度，防止活物质脱落,提高电池使用寿命，增多酸量设计，确保电池不会因电解液枯竭而导致电池使用寿命缩短。
汽车、摩托车起动用蓄电池 随着中国经济的的持续快速发展，汽车工业、通信、电力、交通铁路、计算机系统、广播电视业等基础产业发展十分迅速，这些行业在中国都处于一个高成长期，对铅酸蓄电池和不间断电源的需求日益增长，大大促进了铅酸蓄电池行业在中国的发展，自 90
年代以来进入了蓬勃发展时期，市场不断拓展，技术不断更新，制造水平不断提高。

性能高

(1) 重量、体积小，能量高，内阻小，输出功率大。

(2) 充放电性能高。采用高纯度原料和特殊制造工艺，自放电控制在每个月2%以下，室温(25℃)储存半年以上仍可正常使用。

(3) 恢复性能好，在深放电或者充电器出现故障时，短路放置30天后，仍可充电恢复其容量。

(4) 无需均衡充电。由于单体电池的内阻、容量、浮充电压一致性好， 1 UPS由于是在线式使用，出现故障可以及时报警，并有市电作后备保障，使用者能及时掌握故障并排除故障，不会对事故造成更大的损失。而EPS是离线式使用，是一道供电保障，因而其可靠性设计要求更高，不能简单理解为后备式UPS，否则就把EPS的重要性一笔勾销了。如果EPS在市电故障时，不能通过蓄电池应急供电，则EPS如同虚设，造成的后果将不堪设想。确保电池在浮充状态下无需均衡充电。

主要研究内容及现状

l 模块的封装和互连技术

目前,集成主要采用混合集成方式,因此，封装技术就成为电力电子集成研究的关键。

(1)MCM封装技术：MCM是由一种由两个或者两个以上的裸芯片或者芯片尺寸封装的IC组装在一个基板上的模块，模块组成一个电子系统或子系统。MCM分三种基本类型，一种是MCM-L(采用片状多层基板的);一种是MCM-C(是采用多层陶瓷基板的);另一种是MCM-D(是采用薄膜技术的)。这三种封装形式根据封装的对象不同和封装器件的应用环境不同各有自己的优缺点，在此不再细说了。MCM封装有很多优点，例如提高PCB板的利用率、增强IC的可靠性、增强系统的EMC、优化PCB板的设计和降低投资风险等[2]。

(2)倒装芯片技术：倒装芯片技术是一种将晶片直接与基板相互连接的先进的封装技术。在封装过程中,芯片以面朝下的方式让芯片上的结合点透过金属导体与基板的结合点相互连接的封装技术。和传统的引线键合技术相比，使用倒装芯片技术后，引脚可以放在晶粒正下方的任何地方，而不是只能排列在其四周，这样就能使得引线电感变小、串扰变弱、信号传输时间缩短，从而提高电性能;同时，由于倒装芯片技术可以将导电晶体直接覆盖在晶粒上，从而能够大幅缩小晶粒的尺寸，实现芯片尺寸封装CSP。